

2023臺灣韌體論壇 邀請函

韌體(Firmware)泛指開發晶片程式的各類應用套件，此技術領域於升級台灣工業之設計與研發，不可不備。韌體強調即時演算與通訊，有硬體(Hardware)的反應速度，卻具備軟體(Software)的數位處理的功能，而成為新興的技術領域。因此，臺灣韌體學會每年舉行韌體論壇，於其中，產官學研可以即時交流意見，討論韌體實務與理論，創造人才，升級工業等。今年的臺灣韌體論壇，將於八月二十三於國立中正大學舉行，在此廣發邀請函。欲參與者，煩請填寫受邀表格，回覆電郵，務必勾選擔任論壇主席與專題演講之意願。

以下列舉可能的專題演講題目，但不限於此，僅供參考：

//晶片端韌體

小型作業系統

程式編譯器 (如C、Basic、M-file...等)

計算函式 (如Embedded Computing、Math Functions library...等)

通訊介面 (如Blue tooth、小型TCP/IP...等)

其他 (如自製之各類週邊)

//應用端韌體

電力驅動 (如各類馬達之驅動器)

系統控制 (如辨識、估測、診斷、伺服、人機界面...等)

訊號處理 (如韌體式儀器、韌體式量測，訊號擷取、影像處理、頻譜分析...等)

開發版製作 (教學用開發版或量產之MCU)

其他 (如交通管理、工業燈號、揚聲器音樂...等)

